



### 技术要求

1. 凸块两A表面淬火深2~3mm, 硬度HRC45~55
2. 凸块顶部倒角为2\*45°
3. 如材料用QT60-2时, 其金相组织中球化珠光体不得少于70%. 正火加回火处理HB250~280. A表面不淬火

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校对	李连通				
审核	秦海波				
工艺	刘飞		批准		

### 圆盘



材料: ZG45

XGZ08-04-01-2

共 张 第 张